LAGENAUFBAU HDI (Standard)

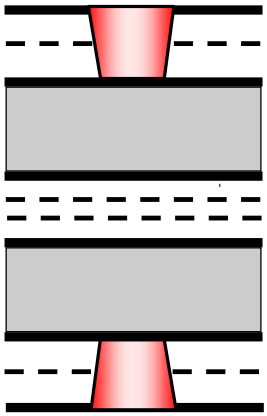
HDI06_1+4+1_1,10_17.5

6 - Lagen

Kerne: 0,36 mm Cu 17/17 µm

WE-Artikel Nr.:		**1 + 4 + 1**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	**66**	
	2			17,5 µm		**16**	
			0,360 mm			**360**	
	3			17,5 µm		**16**	
					2 x 1080	**134**	
	4			17,5 µm		**16**	
			0,360 mm			**360**	
	5			17,5 µm		**16**	
					1 x 1080	**66**	
	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm

Gesamtdicke Material: 1074

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,10**	+/-	0,08	mm			Datum: / Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,18	+/-	0,11	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,24	+/-	0,13	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
05.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	05.01.2006	R. Schönholz	00	7+